

证券代码：688711
转债代码：118040

证券简称：宏微科技
债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2026年7月13日)

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场调研 ☒电话会议 ☐其他
参会单位名单	上海歌斐资产管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司资管、广东正圆私募基金管理有限公司、国海证券、华福证券、招商基金管理有限公司、上海恒穗资产管理中心(有限合伙)、睿远基金管理有限公司、瑞众人寿保险有限责任公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、东方财富证券、国泰基金管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、宝盈基金、东北证券、西部利得基金管理有限公司、中信资管、中泰证券、申万研究所、西部证券、东方证券、天风证券转债、中信建投、招商证券、南京证券（以上排名不分先后）
时间	2026年7月14日 21:00-22:00
地点	线上
上市公司接待人员	董事长 总经理 赵善麒 董事会秘书 马君 市场总监 荣睿 投资总监 陈希
投资者关系活动主要内容	1、公司与北美头部电力设备 SST 客户的最新对接进展如何？未来

内容介绍	预期如何？ 公司与该北美客户已在 UPS、定制化服务器电源、SST 等多个领域开展稳定合作。SST 方面，公司已提供样品，目前处于样机研制阶段，尚未实现收入，样机到量产需经历多轮验证和客户认证，周期长短及最终能否形成稳定订单均存在不确定性。 目前公司在该客户 UPS 采购中占比超过三分之一，SST 领域目标份额力争达到或超过该水平，实际业务推进受客户项目节奏、技术路线选择及市场竞争等多重因素影响，最终份额及收入贡献均存在不确定性。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 2、公司在 SiC 相关技术上的优势是什么，为何能获得北美 SST 客户的认可？在大功率模组、SiC 芯片技术上有哪些新的发展思路？ 技术优势主要体现在：第一，定制化服务经验丰富，自 2014 年起拥有十余年定制化经验，能够贴近客户联合定义产品，兼顾成本优势与服务保障；第二，SiC 模块封装技术积累深厚，是国内最早开展 SiC 封装的企业之一，SiC 产品已覆盖电源、车规、光伏等领域并具备一定出货量；第三，针对客户痛点做定制化差异化开发，迭代速度快；针对 SST 使用特点优化 SiC 芯片与封装特性，减少串扰，提升可靠性。基于长期的经验积累与敏捷的响应机制，公司能够快速为客户提供更贴合场景的解决方案。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 3、公司在高电压等级 SiC 器件（2300V、10kV 等）的技术开发和储备上最新进展如何？ 2300V SiC 产品已开展流片工作，在封装方面，公司正针对现有半桥封装方案痛点开发集成度更高的封装方案。3300V SiC 器件已研发下线，正在进行封装和可靠性试验，未来可应用于 SST 领域。10kV SiC 技术方面，公司与怀柔国家实验室合作成立宏微怀实（控股子公司），相关技术成果将在宏微怀实落地转化。上述产品从流片、试验到量产需较长的认证周期，且应用场景认证标准严苛，技术达标和产业化进度存在不确定性。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。
-------------	--

	4、公司在 PSU 领域的客户开拓进展如何？ 公司正在积极接触相关客户，部分产品已处于送样和小批量阶段。公司同时具备模块、单管等多技术路线解决方案，可满足不同客户差异化需求。上述产品可能存在客户测试不通过，方案测试失败、导入进度延后甚至终止合作风险。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 5、当前功率器件供给紧张的周期大概能延续多久？同时公司对于未来产品的涨价趋势如何判断？ 目前公司订单相对饱满。产能保障方面，公司作为 Fabless 模式企业，已与多家涵盖 IGBT、FRD、SiC、GaN 品类的代工厂建立战略合作关系，芯片产能需求可得到保障。2026 年已启动两轮涨价，主要受上游原材料上涨及公司产能紧张影响，下半年是否涨价需结合市场情况综合决定。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 6、公司的涨价策略是什么？ 公司针对不同客户采用差异化涨价策略，整体而言，产品涨价幅度高于代工厂涨价及成本端涨幅。涨价实施效果受客户接受度、竞对策略和合同条款影响，若客户转单或价格竞争加剧，可能对均价及毛利率产生不利影响，策略的可持续性需结合后续市场环境评估。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 7、公司车规级 SiC 相关业务的进展如何？包括当前出货情况、新定点落地时间、嵌入式封装 SiC 新产品的定位及利润率水平、量产节奏是怎样的？ 2026 年公司车规级 SiC 业务进展显著，全 SiC 模块出货量稳步提升，2026 年上半年暂无新定点，嵌入式封装 SiC 芯片目前尚在积极推进中。该嵌入式封装产品具备体积更小、重量更轻、效率更高、寄生电感更低等优势，毛利率高于普通塑封、灌封类标准模块。该技术路线是未来趋势，但车厂认证流程复杂，暂无法给出明确量产时间。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 8、公司工控、光伏、汽车等各业务领域 2026 年的增长情况如何？
--	--

	2027 年及之后的增长指引是怎样的？ 2026 年上半年汽车领域增幅最大，其次为工控，第三为新能源发电。工控领域增长动力来自数据中心电源及变频器、伺服器等领域需求增长。汽车领域仍有望保持较强增长；新能源发电领域稳中有升，增长主要来自储能业务；公司对持续发展充满信心，新产品储备、客户需求及重大战略合作将成为增长支撑。但以上是基于当前市场判断，不构成业绩预测，2027 年及以后的业绩受宏观经济、产业政策、终端需求等影响较大，具体业绩情况以公司披露的定期报告为准。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 9、公司当前封装产能情况如何？后续的新产能规划是怎样的？ 公司产能利用率稳步攀升，部分产线趋于饱和。公司已在现有厂区附近规划建设二期产能，二期厂房将采用柔性制造、自动化、信息化、智能化生产模式。产能扩建涉及厂房、设备、人员等多环节，实际投产时间、爬坡速度和投资回报存在不确定性，且新增产能能否及时消化存在不确定性。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。
说明	1、接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。前来公司现场调研的投资者均已签署《调研承诺书》。 2、本记录表未列出部分与前期投资者活动重复的问题和回复，详情可查阅公司前期披露的投资者关系活动记录表。 3、本次活动不涉及应当披露重大信息，不构成任何投资建议，本记录表涉及的具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。